

オンボードコンタクト™ ON-BOARD CONTACT / OG



豊富なバリエーションを揃えた超小型グランディングパーツ Super-compact grounding components with wide variations

特長 Feature

- ネジ留めできない箇所でも省スペースでFGが行えます。
- 基板実装に対応したグランド強化部品です。
- バネ部のヘタリ、変形・破損に配慮したBOX構造を取り入れています。(一部品番除く)
- Space saving, FG facilitated even where screws are precluded.
- Grounding component product can be mounted by pick and place machine.
- Box structure is introduced for distortion, deformation and damage prevention.(excluding some part numbers)

材料 Material

- P4-9 参照
- Refer to page 4-9

■ コンパクトタイプ Compact type



狭い場所での使用に対応するため小型化を図っています
Down-sized compact type for narrow space configurations.

■ 省スペースタイプ Space saving type



基板上のパッドエリアを省スペース化
For space saving at pad area on PC board

■ ハイポイントタイプ Large height type



広いクリアランスでの使用に対応
For large clearances

■ センター吸着タイプ Centered vacuum pick-up type



吸着ポイントをセンターに配置
Vacuum pick-up point is placed at center

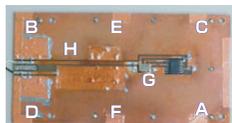
■ 評価基板を用いた多点接地による放射ノイズ低減効果の検証 Suppression of radiated emission by multi point grounding

<実験内容>

- 実験1 評価基板 + 金属板(FG接続なし)
- 実験2 評価基板 + 金属板(FG接続4Point) 接地位置 A,B,C,D
- 実験3 評価基板 + 金属板(FG接続8Point) 接地位置 A,B,C,D,E,F,G,H

<Experimental contents>

- Exp 1: PC board + Metal plate (without grounding)
- Exp 2: PC board + Metal plate (4 points:A, B, C, D)
- Exp 3: PC board + Metal plate (8 points :A, B, C, D, E, F, G, H)

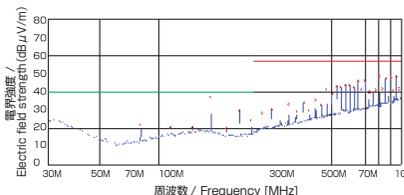


評価基板の接地Point
GND point on test PC board



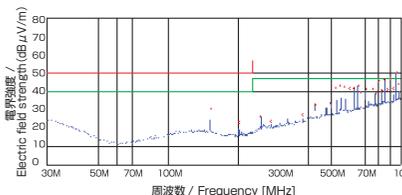
Electric field strength

1) FG接続なし / Without FG connection



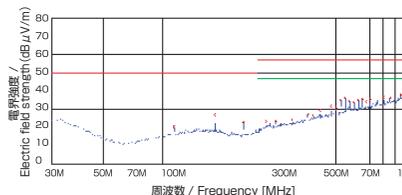
フレームグランド / Frame ground

2) 4点接地 / 4 point grounding



フレームグランド / Frame ground

3) 8点接地 / 8 point grounding



フレームグランド / Frame ground

多点接地によるグランド強化は大きなノイズ低減効果が期待できる。
Multi point grounding enables large suppression effectiveness.

※本製品のご検討・ご採用に際しましてはP2下の「オンボードシリーズについて」をご確認ください。
※Please confirm "Notes for On-board series" on page 2 prior to purchase.

※参考実測データ / 保証値ではありません。

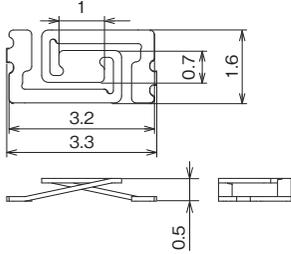
※The values are measured data for reference, not guaranteed.

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。

Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.

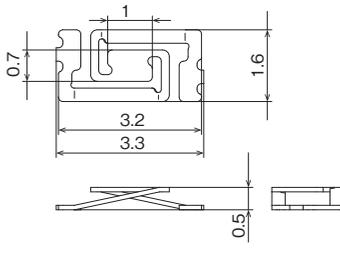
オンボードコンタクト™ ON-BOARD CONTACT / OG

OG-321605



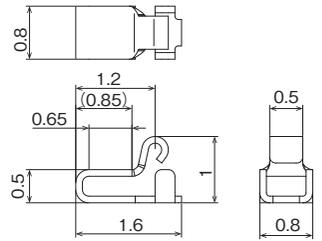
材料：ばね用りん青銅(t=0.1mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.1mm)
表面处理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ0.35mm以下(推奨)
Recommended height: 0.35mm or less

OG-321605G



材料：ばね用りん青銅(t=0.1mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.1mm)
表面处理：部分Auめっき(Niめっき下地)
Surface treatment: Partial Au plating (Ni Base plating)
使用範囲：製品高さ0.35mm以下(推奨)
Recommended height: 0.35mm or less

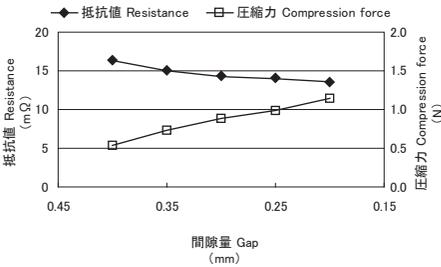
OG-160810S



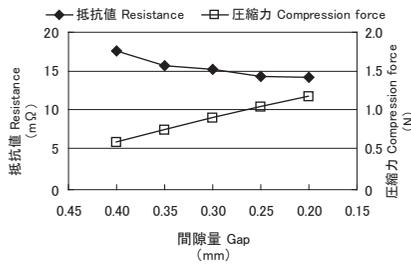
材料：ベリリウム銅(t=0.1mm)
Material: Beryllium copper (t=0.1mm)
表面处理：部分Auめっき(Niめっき下地)
Surface treatment: Partial Au plating (Ni Base plating)
使用範囲：製品高さ0.7~0.9mm(推奨)
Recommended height: 0.7~0.9mm

圧縮抵抗特性データ / Compression force vs Electric resistance

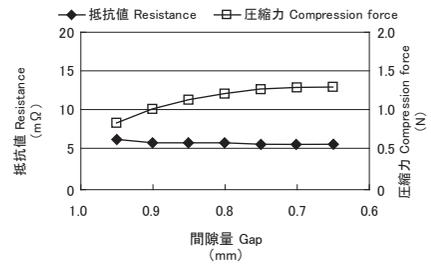
OG-321605



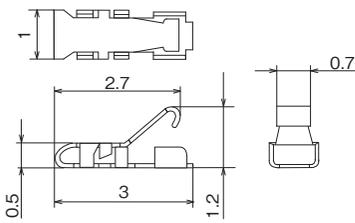
OG-321605G



OG-160810S

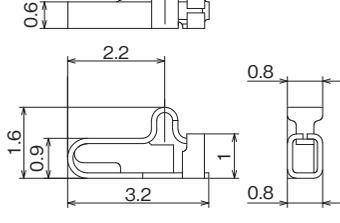


OG-301012



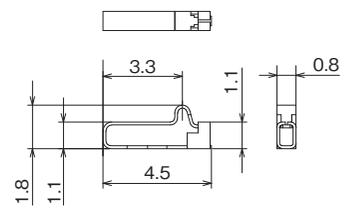
材料：ばね用りん青銅(t=0.08)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.08mm)
表面处理：部分Auめっき
Surface treatment: Partial Au plating
使用範囲：製品高さ0.6~1.1mm(推奨)
Recommended height: 0.6~1.1mm

OG-320816



材料：ばね用りん青銅(t=0.12mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.12mm)
表面处理：部分Auめっき
Surface treatment: Partial Au plating
使用範囲：製品高さ1.1~1.4mm(推奨)
Recommended height: 1.1~1.4mm

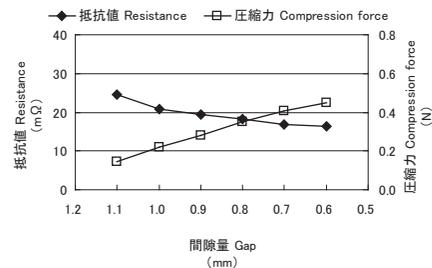
OG-450818



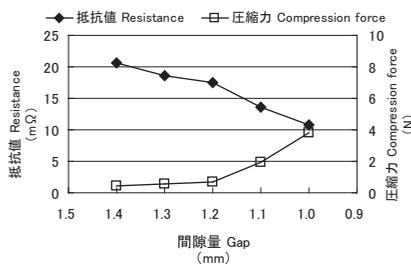
材料：ベリリウム銅(t=0.12mm)
Material: Beryllium copper (t=0.12mm)
表面处理：部分Auめっき
Surface treatment: Partial Au plating
使用範囲：製品高さ1.2~1.6mm(推奨)
Recommended height: 1.2~1.6mm

圧縮抵抗特性データ / Compression force vs Electric resistance

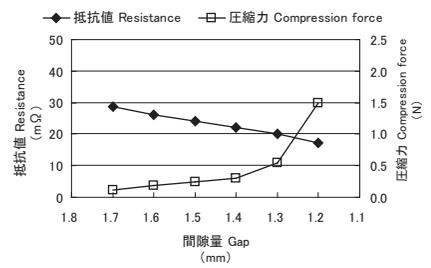
OG-301012



OG-320816



OG-450818



※本製品のご検討・ご採用に際しましてはP2下の「オンボードシリーズについて」をご確認ください。
※Please confirm "Notes for On-board series" on page 2 prior to purchase.

※参考実測データ / 保証値ではありません。

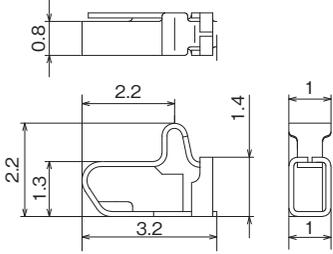
※The values are measured data for reference, not guaranteed.

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。

Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.

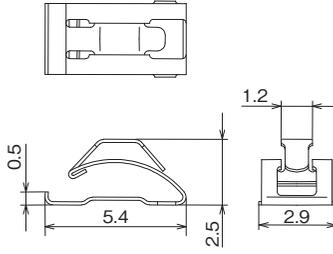
オンボードコンタクト™ ON-BOARD CONTACT / OG

OG-321022



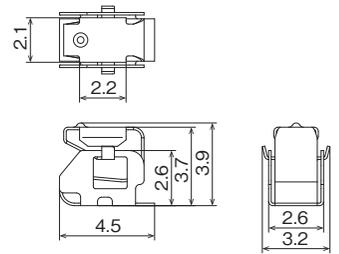
材料：ばね用りん青銅(t=0.12mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.12mm)
表面处理：部分Auめっき
Surface treatment: Partial Au plating
使用範囲：製品高さ1.5~2mm(推奨)
Recommended height: 1.5~2mm

OG-542925



材料：ばね用りん青銅(t=0.12mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.12mm)
表面处理：部分Auめっき
Surface treatment: Partial Au plating
使用範囲：製品高さ1.5~2.3mm(推奨)
Recommended height: 1.5~2.3mm

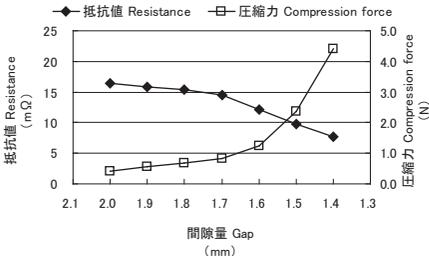
OG-453239-A



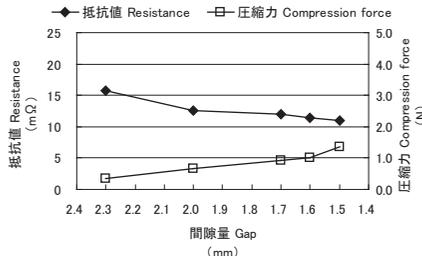
材料：ベリリウム銅(t=0.12mm)
Material: Beryllium copper (t=0.12mm)
表面处理：Snリフローめっき(Cuめっき下地)
Surface treatment: Sn reflow plating (Cu Base plating)
使用範囲：製品高さ2.8~3.5mm(推奨)
Recommended height: 2.8~3.5mm

圧縮抵抗特性データ/Compression force vs Electric resistance

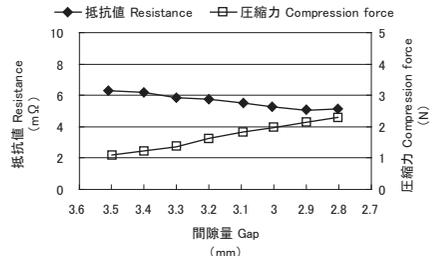
OG-321022



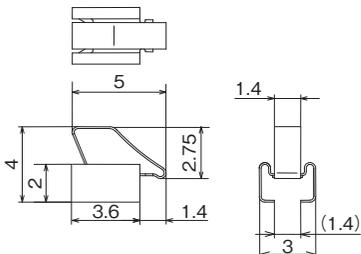
OG-542925



OG-453239-A

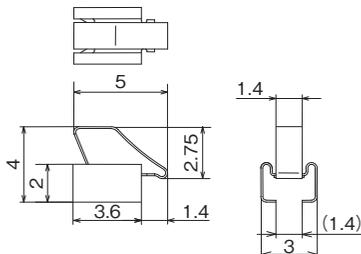


OG-363040



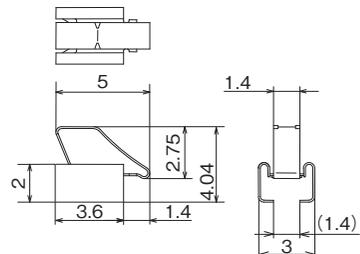
材料：ベリリウム銅(t=0.1mm)
Material: Beryllium copper (t=0.1mm)
表面处理：Snリフローめっき(接点部Niめっき)
Surface treatment: Sn reflow plating (Ni plated contacts)
使用範囲：製品高さ2.2~3.4mm(推奨)
Recommended height: 2.2~3.4mm

OG-363040G



材料：ベリリウム銅(t=0.1mm)
Material: Beryllium copper (t=0.1mm)
表面处理：部分Auめっき
Surface treatment: Partial Au plating
使用範囲：製品高さ2.2~3.4mm(推奨)
Recommended height: 2.2~3.4mm

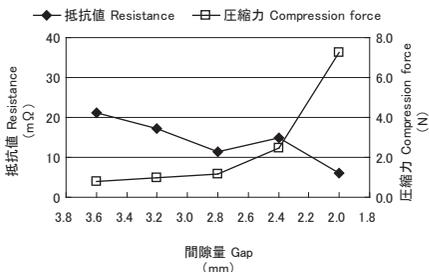
OG-363040HD



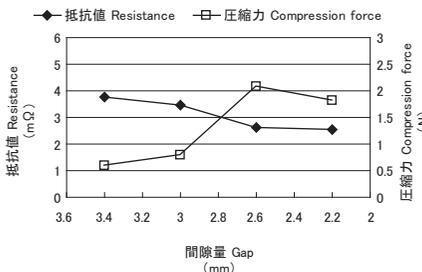
材料：ベリリウム銅(t=0.1mm)
Material: Beryllium copper (t=0.1mm)
表面处理：Snリフローめっき(接点部Niめっき)
Surface treatment: Sn reflow plating (Ni plated contacts)
使用範囲：製品高さ2.2~3.4mm(推奨)
Recommended height: 2.2~3.4mm

圧縮抵抗特性データ/Compression force vs Electric resistance

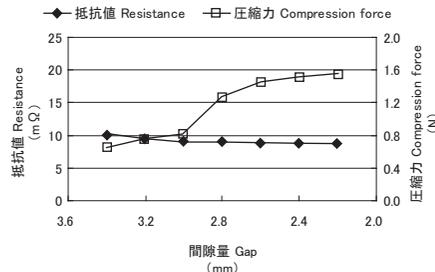
OG-363040



OG-363040G



OG-363040HD



※本製品のご検討・ご採用に際しましてはP2下の「オンボードシリーズについて」をご確認ください。

※Please confirm "Notes for On-board series" on page 2 prior to purchase.

※参考実測データ/保証値ではありません。

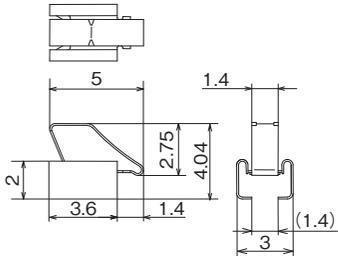
※The values are measured data for reference, not guaranteed.

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。

Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.

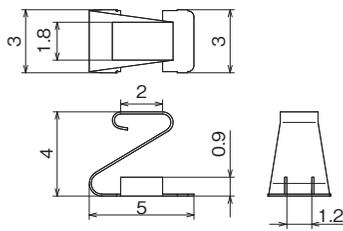
オンボードコンタクト™ ON-BOARD CONTACT / OG

OG-363040HDR



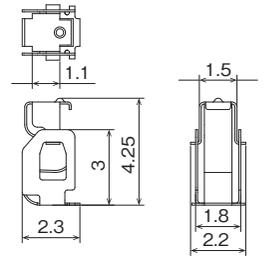
材料：ばね用りん青銅(t=0.1mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.1mm)
表面処理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ2.2~3.4mm(推奨)
Recommended height: 2.2~3.4mm

OG-503040



材料：ベリリウム銅(t=0.1mm)
Material: Beryllium copper (t=0.1mm)
表面処理：Snめっき
Surface treatment: Sn plating
使用範囲：製品高さ2.2~3.6mm(推奨)
Recommended height: 2.2~3.6mm

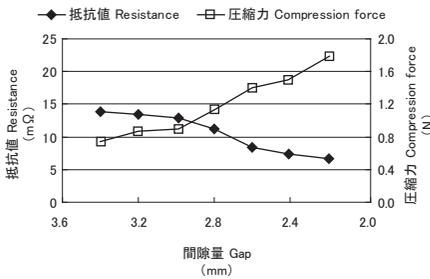
OG-232242



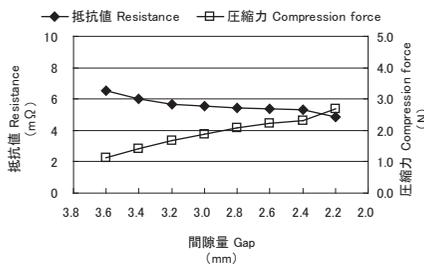
材料：ばね用りん青銅(t=0.08mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.08mm)
表面処理：Snリフローめっき(Cuめっき下地)
Surface treatment: Sn reflow plating (Cu Base plating)
使用範囲：製品高さ3.2~4.0mm(推奨)
Recommended height: 3.2~4.0mm

圧縮抵抗特性データ/Compression force vs Electric resistance

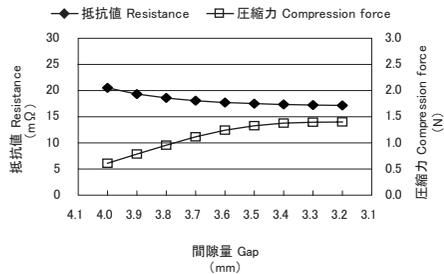
OG-363040HDR



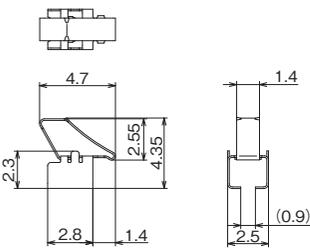
OG-503040



OG-232242

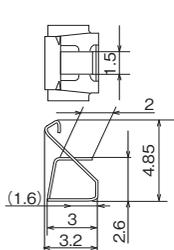


OG-282543HDR



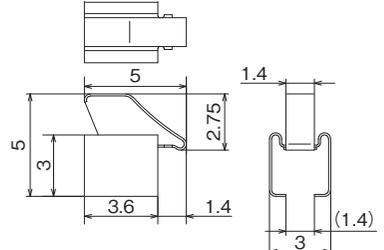
材料：ばね用りん青銅(t=0.1mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.1mm)
表面処理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ2.5~3.9mm(推奨)
Recommended height: 2.5~3.9mm

OG-453048



材料：ばね用りん青銅(t=0.1mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.1mm)
表面処理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ2.7~4.4mm(推奨)
Recommended height: 2.7~4.4mm

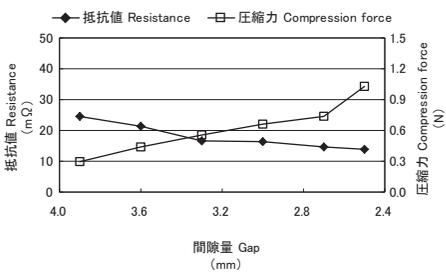
OG-363050



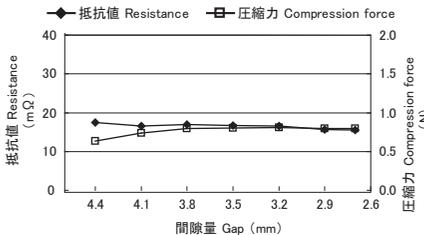
材料：ベリリウム銅(t=0.1mm)
Material: Beryllium copper (t=0.1mm)
表面処理：Snリフローめっき(接点部Niめっき)
Surface treatment: Sn reflow plating (Ni plated contacts)
使用範囲：製品高さ3.2~4.4mm(推奨)
Recommended height: 3.2~4.4mm

圧縮抵抗特性データ/Compression force vs Electric resistance

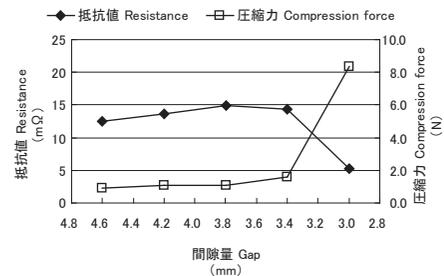
OG-282543HDR



OG-453048



OG-363050



※本製品のご検討・ご採用に際しましてはP2下の「オンボードシリーズについて」をご確認ください。

※Please confirm "Notes for On-board series" on page 2 prior to purchase.

※参考実測データ/保証値ではありません。

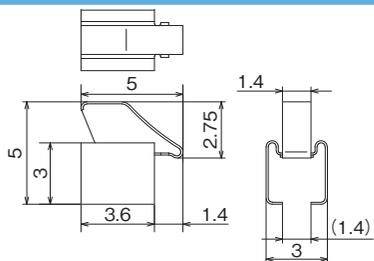
※The values are measured data for reference, not guaranteed.

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。

Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.

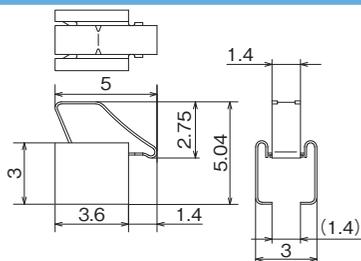
オンボードコンタクト™ ON-BOARD CONTACT / OG

OG-363050G



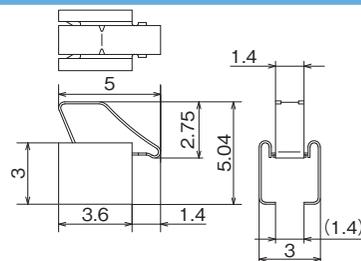
材料：ベリリウム銅(t=0.1mm)
Material: Beryllium copper (t=0.1mm)
表面処理：部分Auめっき
Surface treatment: Partial Au plating
使用範囲：製品高さ3.2~4.4mm(推奨)
Recommended height: 3.2~4.4mm

OG-363050HD



材料：ベリリウム銅(t=0.1mm)
Material: Beryllium copper(t=0.1mm)
表面処理：Snリフローめっき(接点部Niめっき)
Surface treatment: Sn reflow plating(Ni plated contacts)
使用範囲：製品高さ3.2~4.4mm(推奨)
Recommended height: 3.2~4.4mm

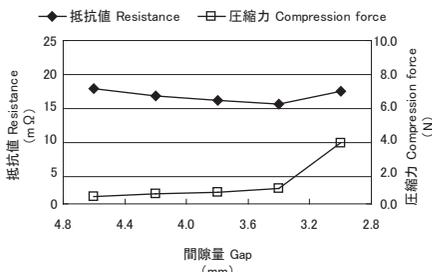
OG-363050HDR



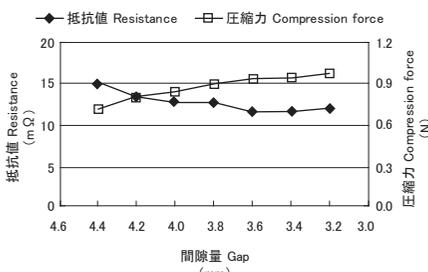
材料：ばね用りん青銅(t=0.1mm)
Material: Phosphor bronze for spring(t=0.1mm)
表面処理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ3.2~4.4mm(推奨)
Recommended height: 3.2~4.4mm

圧縮抵抗特性データ/Compression force vs Electric resistance

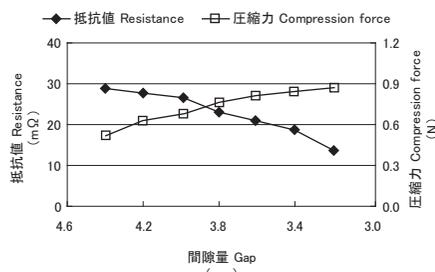
OG-363050G



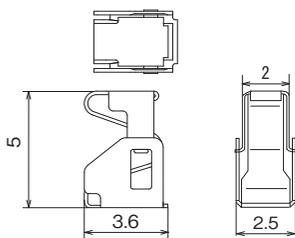
OG-363050HD



OG-363050HDR

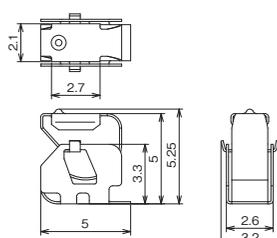


OG-362550



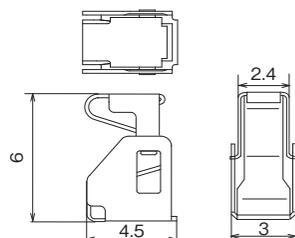
材料：ばね用りん青銅(t=0.15mm)
Material: Phosphor bronze for spring(t=0.15mm)
表面処理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ3.6~4.5mm(推奨)
Recommended height: 3.6~4.5mm

OG-503253-A



材料：ベリリウム銅(t=0.12mm)
Material: Beryllium copper (t=0.12mm)
表面処理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ3.5~4.5mm(推奨)
Recommended height: 3.5~4.5mm

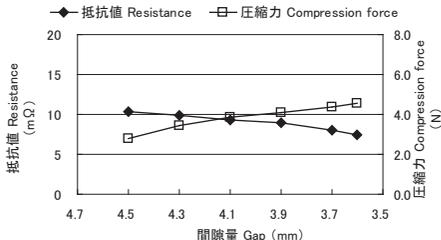
OG-453060



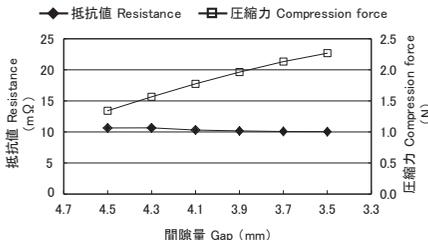
材料：ばね用りん青銅(t=0.2mm)
Material: Phosphor bronze for spring(t=0.2mm)
表面処理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ4.2~5.5mm(推奨)
Recommended height: 4.2~5.5mm

圧縮抵抗特性データ/Compression force vs Electric resistance

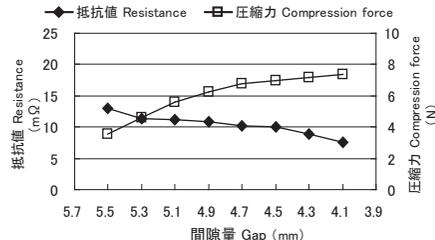
OG-362550



OG-503253-A



OG-453060



※本製品のご検討・ご採用に際しましてはP2下の「オンボードシリーズについて」をご確認ください。

※Please confirm "Notes for On-board series" on page 2 prior to purchase.

※参考実測データ/保証値ではありません。

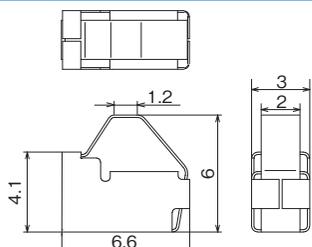
※The values are measured data for reference, not guaranteed.

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。

Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.

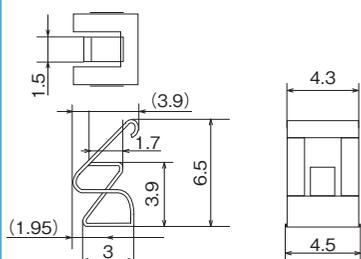
オンボードコンタクト™
ON-BOARD CONTACT / OG

OG-603060



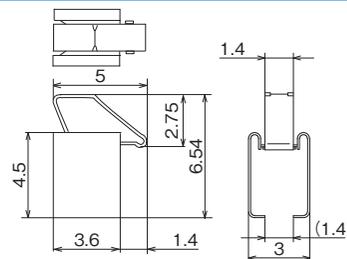
材料：ばね用りん青銅(t=0.12mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.12mm)
表面处理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ4.2~5.5mm(推奨)
Recommended height: 4.2~5.5mm

OG-453065



材料：ばね用りん青銅(t=0.15mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.15mm)
表面处理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ4.2~6.0mm(推奨)
Recommended height: 4.2~6.0mm

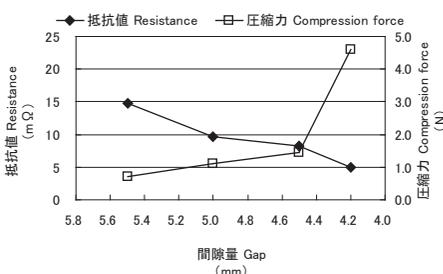
OG-363065HD



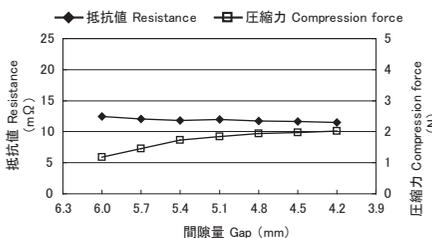
材料：ベリリウム銅(t=0.1mm)
Material: Beryllium copper(t=0.1mm)
表面处理：Snリフローめっき(接点部Niめっき)
Surface treatment: Sn reflow plating(Ni plated contacts)
使用範囲：製品高さ4.7~5.9mm(推奨)
Recommended height: 4.7~5.9mm

圧縮抵抗特性データ / Compression force vs Electric resistance

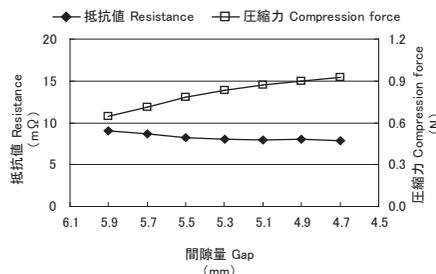
OG-603060



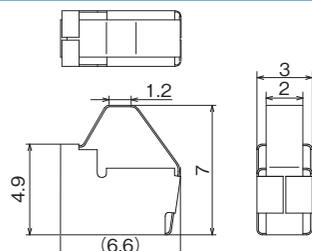
OG-453065



OG-363065HD

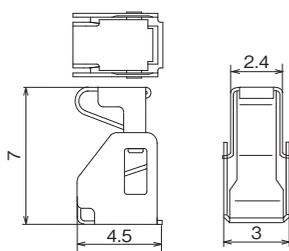


OG-603070



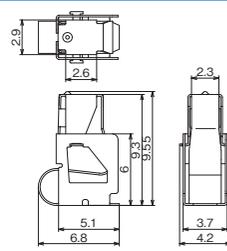
材料：ばね用りん青銅(t=0.08mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.08mm)
表面处理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ5~6.5mm(推奨)
Recommended height: 5~6.5mm

OG-453070



材料：ばね用りん青銅(t=0.2mm)
Material: Phosphor bronze for spring (t=0.2mm)
表面处理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ5.3~6.5mm(推奨)
Recommended height: 5.3~6.5mm

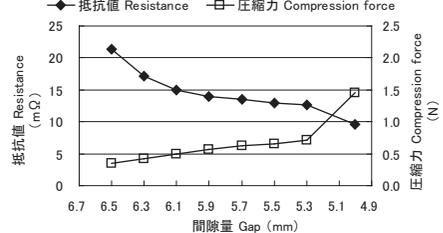
OG-684296



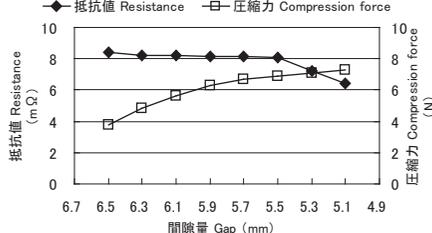
材料：ベリリウム銅(t=0.15mm)
Material: Beryllium copper (t=0.15mm)
表面处理：Snリフローめっき
Surface treatment: Sn reflow plating
使用範囲：製品高さ7.0~9.0mm(推奨)
Recommended height: 7.0~9.0mm

圧縮抵抗特性データ / Compression force vs Electric resistance

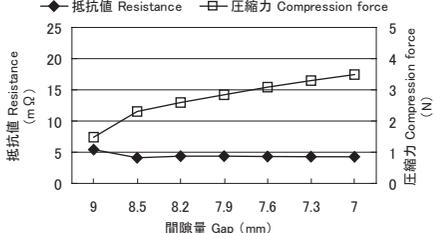
OG-603070



OG-453070



OG-684296



※本製品のご検討・ご採用に際しましてはP2下の「オンボードシリーズについて」をご確認ください。
※Please confirm "Notes for On-board series" on page 2 prior to purchase.

※参考実測データ / 保証値ではありません。

※The values are measured data for reference, not guaranteed.

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。

Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.